

ULVAC SINKU-RIKO

## 薄板, フィルム状試料, コーティング層の 伝熱特性の評価に。

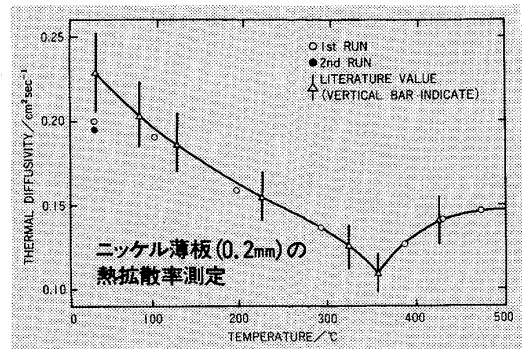
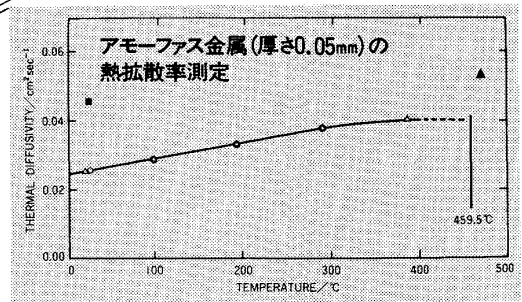
### 光交流法熱定数測定装置

# PIT-1

**新製品**

現在、半導体素子のICメモリをはじめとして、薄膜、厚膜、薄板状試料はますます多用される傾向にあります。これらの材料の熱的特性を知ることは製品開発に極めて重要ですが、既存の測定技術では決して容易なことではありませんでした。PIT-1はACカロリメトリの原理を応用し、世界に先駆けて厚さ0.005mmの極薄材料に挑戦。材料の面方向の熱拡張率、比熱、熱伝導率測定を可能にしました。従来測定困難であったアモーフス金属、半導体材料、セラミック薄板、基板上のダイヤモンド膜、高分子フィルムなどの伝熱特性の評価に不可欠なデータを提供することができます。

- 試料サイズ: 熱拡散率用10×4mm、厚0.3mm以下 比熱用4×4mm、厚0.1~0.3mm
- 熱拡散率測定範囲: 0.005~2.0cm<sup>2</sup>/s
- 測定温度: 室温~500℃
- 測定精度: ±5%(再現性)



## 真空理工株式会社

AE事業部

本社営業部 〒226 横浜市緑区白山町300 ☎(045)931-2285~7  
大阪営業所 〒530 大阪市北区梅田1-11-4 2100 大阪駅前第4ビル  
☎(06)344-0325

経団連会館  
〒三階 法人日本録協  
郵便振替口座東京三〇七九一六〇二番  
(会員の購読料は  
会費に含まれる)